

次世代半導体パッケージ検査装置の開発及び実証（株式会社Holoway）



所在地	創設年	創設者名
兵庫県神戸市	2023年	佐藤 邦弘

パートナーVC	直近の資金調達ラウンド	企業価値
グロービス・キャピタル・パートナーズ	シリーズA	2,635百万円

会社連絡先：非公開

ホームページリンク：<https://holoway.co.jp>

○事業概要

独自のデジタルホログラフィ技術シーズを応用し、AI・自動運転・メタバース等の社会実装に向けて期待が高まる次世代半導体パッケージにおいて求められる測定検査ソリューションを開発する。

○事業内容

本研究開発では、独自のデジタルホログラフィ技術を半導体測定検査ソリューションへと昇華させ、高精度と高スループットの両立を実現することによって、加工技術の更なるイノベーション創出とQCD向上が求められる先端半導体プロセスにおける課題解決を図る。

事業領域・分野	事業年度	交付決定額	海外技術実証
情報・通信	STS 2025～2027年度	292百万円	アジア、アメリカ、ヨーロッパ